

株式会社ジェイ・イー・ティ

2024年12月期
第3四半期決算説明資料

2024年11月8日

The background of the slide is a detailed, blue-toned illustration of a circuit board. It features various components like a central chip, traces, and connectors, with a glowing effect. In the lower right quadrant of this background, there is a small bar chart with five bars of increasing height.

2024年12月期第3四半期 連結決算概要 当期TOPIX

業績サマリー

韓国メモリーメーカー及び中国ファウンドリ向け洗浄装置立ち上げ
2Qは回復も、3Qは韓国メモリーメーカー投資小休止の影響を受け厳しい決算に

売上高
14,291百万円

営業利益
755百万円

経常利益
688百万円

当期純利益
403百万円

前期比 $\triangle 27.5\%$ 前期比 $\triangle 63.4\%$ 前期比 $\triangle 63.2\%$ 前期比 $\triangle 68.2\%$

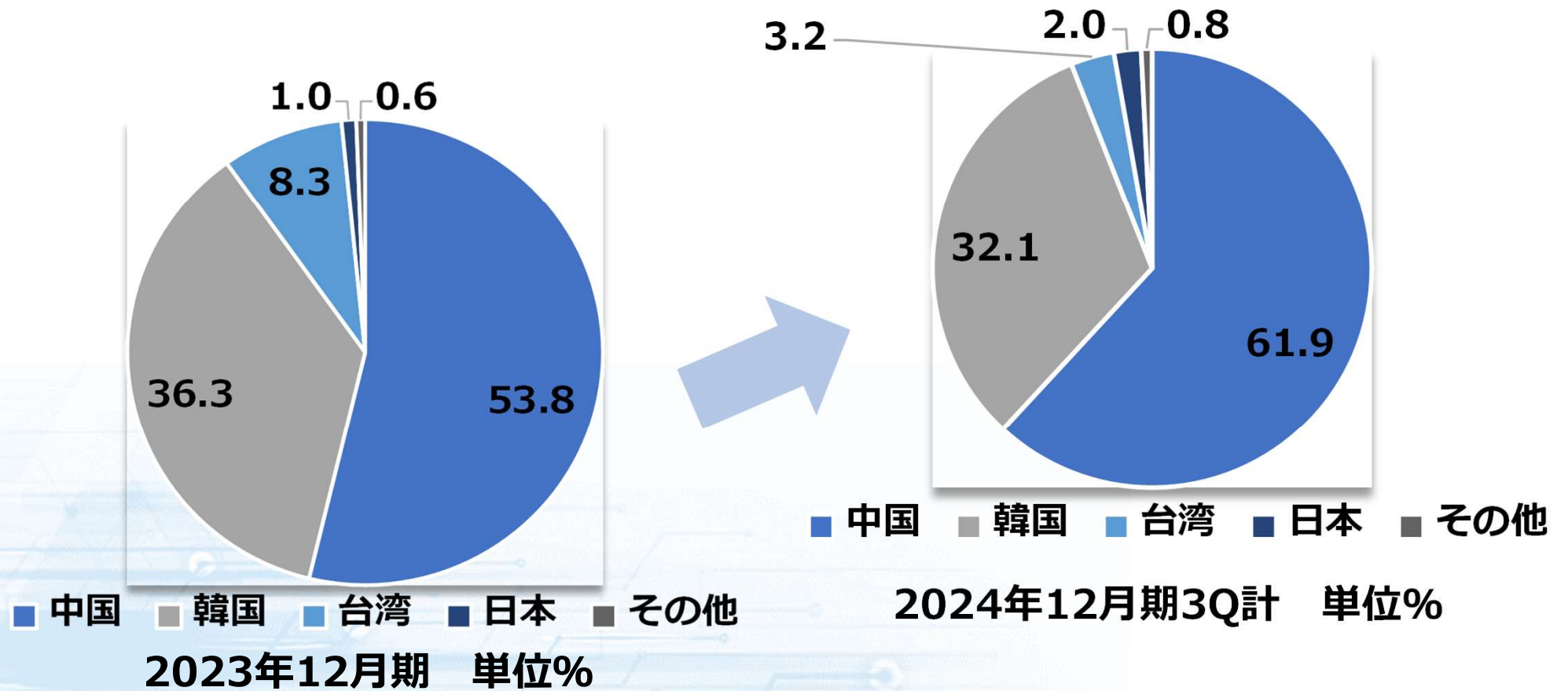
- ✓ DRAMについては生成AI向けサーバーやGPUに多くのHBM (High Bandwidth Memory) が使用され、DRAM価格は上昇に転じ3D-NAND向け含め、新たな設備投資が増加
- ✓ 中国については、ここ数年間の成熟世代半導体向け新規設備投資増強の反動からファウンドリにて設備稼働率が停滞、投資減速の傾向

単位 (百万円)	2023年3Q	売上比 (%)	2024年3Q	売上比 (%)	対前期比 (%)	通期予想	進捗率 (%)
売上高	19,726	—	14,291	—	△27.5%	21,480	66.5%
売上総利益	4,157	21.1%	2,977	20.8%	△28.4%		
販管費	2,093	10.6%	2,221	15.5%	6.1%		
営業利益	2,064	10.5%	755	5.3%	△63.4%	1,460	51.7%
経常利益	1,872	9.5%	688	4.8%	△63.2%	1,350	51.0%
当期純利益	1,270	6.4%	403	2.8%	△68.2%	900	44.8%

単位未満切り捨て

- ✓ 売上高は前期比27.5%減収、営業利益は63.4%減益
- ✓ 計画していたコストダウン（材料費・外注費等）が進まず、売上高減少のため抑制はしているものの、販管費率上昇、製品構成の変化なども利益を圧迫

半導体事業 地域別売上高構成比推移



連結貸借対照表

単位（百万円）	2023年12月期	2024年3Q	増減	主な増減要因
流動資産	27,068	25,245	△1,823	「商品・製品」「仕掛品」の減少
有形固定資産	954	1,076	122	
無形固定資産	56	101	45	
投資その他資産	695	738	43	
資産合計	28,774	27,161	△1,613	
流動負債	11,496	10,202	△1,294	「前受金」の減少
固定負債	4,866	4,544	△322	長期借入金の減少
負債合計	16,362	14,747	△1,615	
純資産合計	12,411	12,414	3	「資本剰余金」の増加 「利益剰余金」の減少
負債純資産合計	28,774	27,161	△1,613	

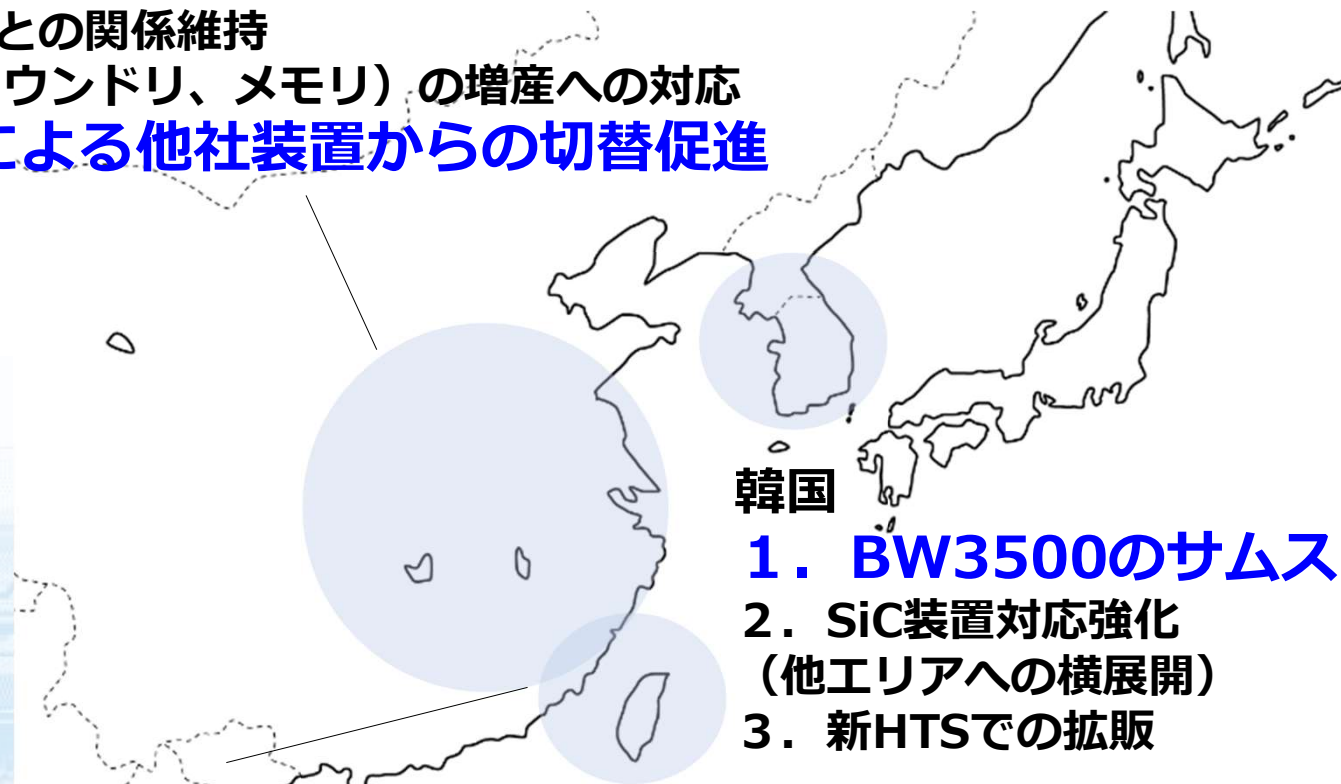
単位未満切り捨て

トピックス BW3500 中国、韓国で引き合い

中国、韓国、台湾など主要エリア戦略の要となるBW3500の開発を終え、販売を開始
3Q期間に中国、韓国で引き合い対応中

中国

1. SMICグループとの関係維持
2. 既存顧客（ファウンドリ、メモリ）の増産への対応
3. **BW3500による他社装置からの切替促進**



韓国

1. **BW3500のサムスンでの拡販**
2. SiC装置対応強化
(他エリアへの横展開)
3. 新HTSでの拡販

台湾

1. TSMC向けHTS/03の対応を優先
(他エリアへの横展開)
2. 既存顧客との関係維持
3. **BW3500 による他社装置からの切替促進**

主力機種BW3000が開発から20年を経過、より顧客ニーズに応えられる後継機種

- 今後投資の中心になる**28nm以上のプロセスをターゲットに**
- **RCA洗浄の他社製品からの切替を意識**

BW3000からの改善点

1. フットプリントの削減
(装置面積にて15~16%、装置全長で20%の削減)
2. 新たな搬送方式の採用
(搬送アームに加え、Moving / Single Liferによる搬送)
3. 環境・安全対策
(OHT専用PORTの設置、薬液霧困気漏れ軽減の機密性向上)
4. 破損防止対策 (樹脂槽の採用)
5. 操作性向上 (操作画面の大型化、カラー化、情報量アップ)

ほか、ONE BATH、メタルイオン対策、新排気システム、薬液使用量削減、スループット向上、新乾燥システムの採用などを実現



BW3500

- ✓ 欧米のインフレは落ち着きつつあり金融政策も金融緩和の時期を探る段階に入るも、引き続き地政学的なリスクなど受け不透明要因の多い市場環境
- ✓ エレクトロニクス製品を含む世界的な消費停滞も継続
- ✓ 半導体市況においては想定されていた2024年からの市況回復が後ずれ
- ✓ DRAMにおいては生成AI向けサーバーやGPUにはHBMが使用され、DRAM価格は上昇、新たな設備投資も増加
- ✓ 成熟世代半導体向けの設備投資は、米中関係の緊張もあり中国で継続も、一部ファウンドリで設備稼働率が停滞、投資減速の傾向
- ✓ 中国市場においては成熟世代半導体領域で新興洗浄装置メーカーとの競争も増加

通期業績予想

通期業績予想は変わらず

ただし、半導体メーカーの工場立上遅延に連動した洗浄装置立上遅延の影響を注視

売上高 21,480百万円	営業利益 1,460百万円	経常利益 1,350百万円	当期純利益 900百万円
前期比 ▲14.0%	前期比 ▲44.1%	前期比 ▲44.8%	前期比 ▲45.5%

- ✓ 現状、通期業績目標の必達を意識し市況の停滞感や現地新興洗浄装置メーカーとの競合などはあるも、営業に注力中
- ✓ また、なお受注残はあり、次の飛躍に向け充電するこの期に、顧客ニーズに対応した装置開発や製造体制の強化に注力

中長期成長戦略

長期連結業績（売上高・営業利益）推移

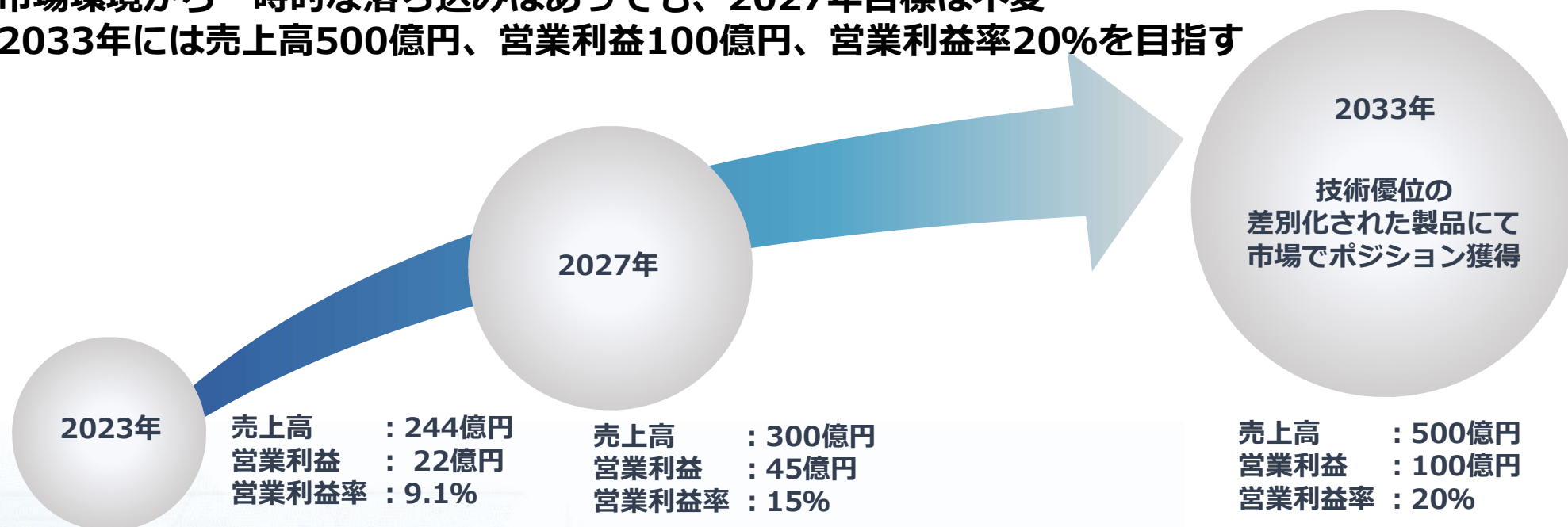
シリコンサイクルの影響を受けながら、これまでも半導体需要の増加に伴い成長
2024年は我慢の年度になるも中長期的な成長を期す



* 2019年以前の数字は監査法人による監査を受けていない参考数字

中長期 数値目標と4つの軸での戦略

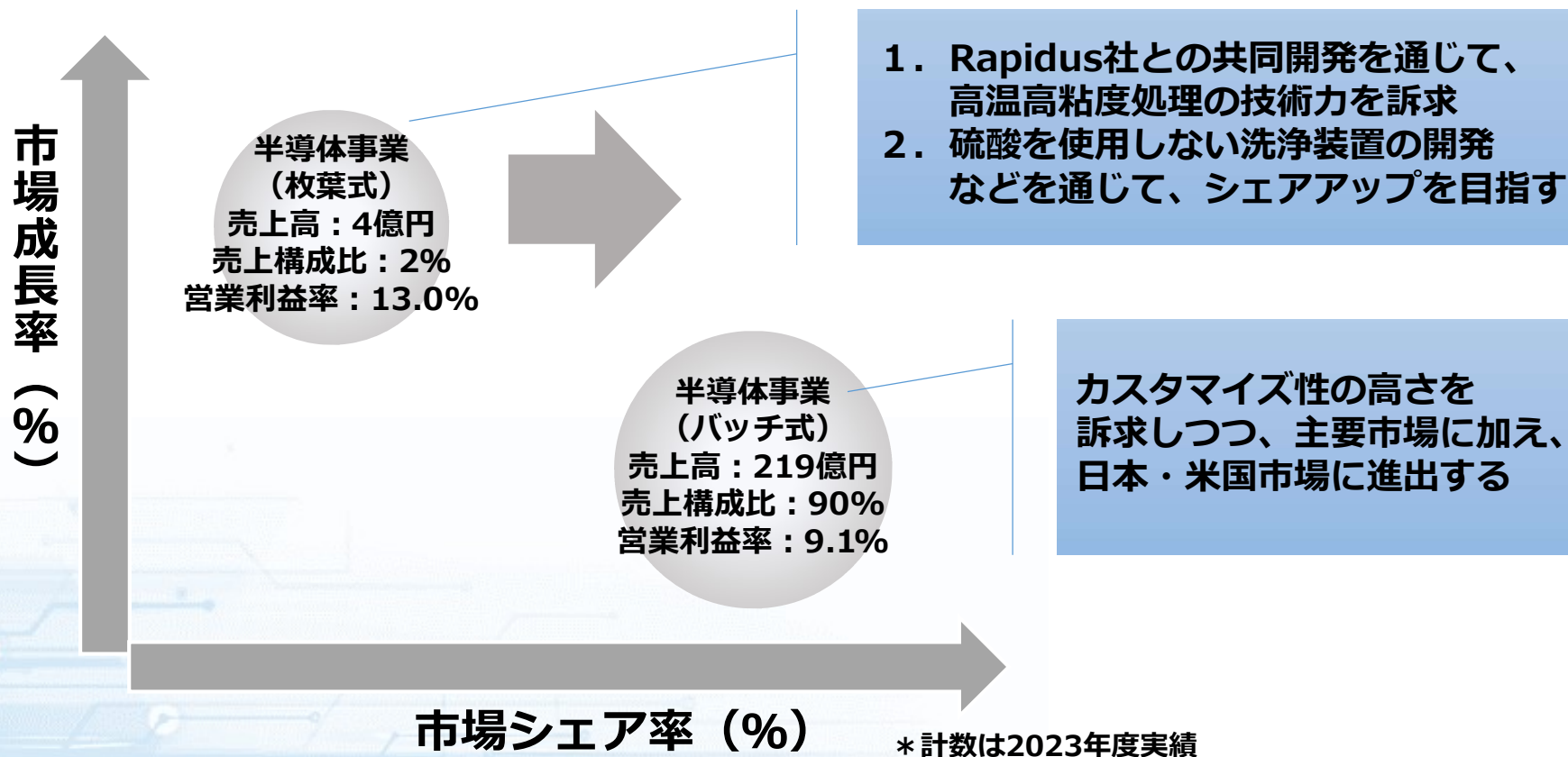
市場環境から一時的な落ち込みはあっても、2027年目標は不変
2033年には売上高500億円、営業利益100億円、営業利益率20%を目指す



製品戦略	エリア戦略	組織戦略	製造戦略
<ul style="list-style-type: none"> ・ バッチ式洗浄装置 処理槽の構成や設置数の カスタマイズ性の高さを訴求 ・ 枚葉式洗浄装置 高温高粘度薬液への対応を 推進し差別化を図る ・ GXへの対応 硫酸を使用しない洗浄装置の 開発等GXへの対応を行う 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 主要市場(韓国、中国、台湾) 既存のリレーションを通じ取 引濃化を進める ・ 米国市場 : 現地法人を開設、 "レガシー半導体領域"での顧 客開拓に注力 ・ 日本市場 : 日本の優位性が高 い車載用半導体や、国内回帰 を進めるメーカーの開拓強化 	<ul style="list-style-type: none"> ・ システムデザイン部の新設 当社の強みは、カスタマイズ 性の高さと高温高粘度処理の 技術。房野社長の指導の下、 一流の技術営業部隊を育成し、 質の高い提案型営業を実現す る ・ 営業強化 : 米国へは初めて、 日本へは15年ぶりに進出。商 文化の違いを踏まえ顧客開拓 	<ul style="list-style-type: none"> ・ サプライチェーン強化 景気変動の影響を強く受ける 半導体業界において、生産能 力の弾力化は必須。 協力会社との関係を強化し、 ファブレス化を推進する ・ 新工場建設 : 生産能力の拡大 や生産効率化、R&Dの強化を 企図し新工場を建設する

戦略 成長への事業ポートフォリオ整理

バッチ式のシェアを守りつつ、差別化された枚葉式洗浄装置で成長を期す



- バッチ式洗浄装置は、今後も一定の市場規模を維持しつつ、半導体市場の成長に伴い緩やかに市場成長する見通し
 当社は世界シェア11%を占めており、今後も市場シェア率の拡大を目指す
- 枚葉式洗浄装置は、今後も主要な洗浄装置である可能性が高く、半導体の市場の成長に伴い大きく市場成長する見通し
 当社は高温高粘度処理に対応した枚葉式洗浄装置の開発・販売を通じて、市場シェアの拡大を目指す

Appendix

リーマン・ショック後の半導体不況時に民事再生手続を開始し、その後破産手続に移行したエス・イー・エス(株)が前身
同社の卓越した半導体洗浄装置に関する技術を継承すべく、
 販売代理店であった韓国企業のZEUS CO., LTD. (以下、「ZEUS」) の全額出資のもと、
 2009.4.24に設立、2009.5に**エス・イー・エス(株)の岡山工場等を事業譲渡により引き継ぎ誕生**

■ 会社概要

会社名	株式会社ジェイ・イー・ティ
英訳名	J.E.T. Co., LTD.
設立	2009年4月
資本金	1,848百万円 (2023年12月31日時点)
所在地	岡山県浅口郡里庄町新庄金山6078番
TEL	0865-69-4080
代表者	代表取締役社長 房野 正幸
従業員数	171名 298名 ※連結会社含む全従業員数 (2024年6月30日時点)
事業内容	半導体洗浄装置の開発・製造・販売・ アフターサービス等
主要納入先	サムスン電子 (韓国) SMIC (中国)

グループ関係図

親会社ZEUSとは事業の棲み分けがなされ、競合関係もなく、経営についても役職員の出向等の受け入れを廃止し独立性の確保を図る



所在地： 大韓民国
京畿道華城市

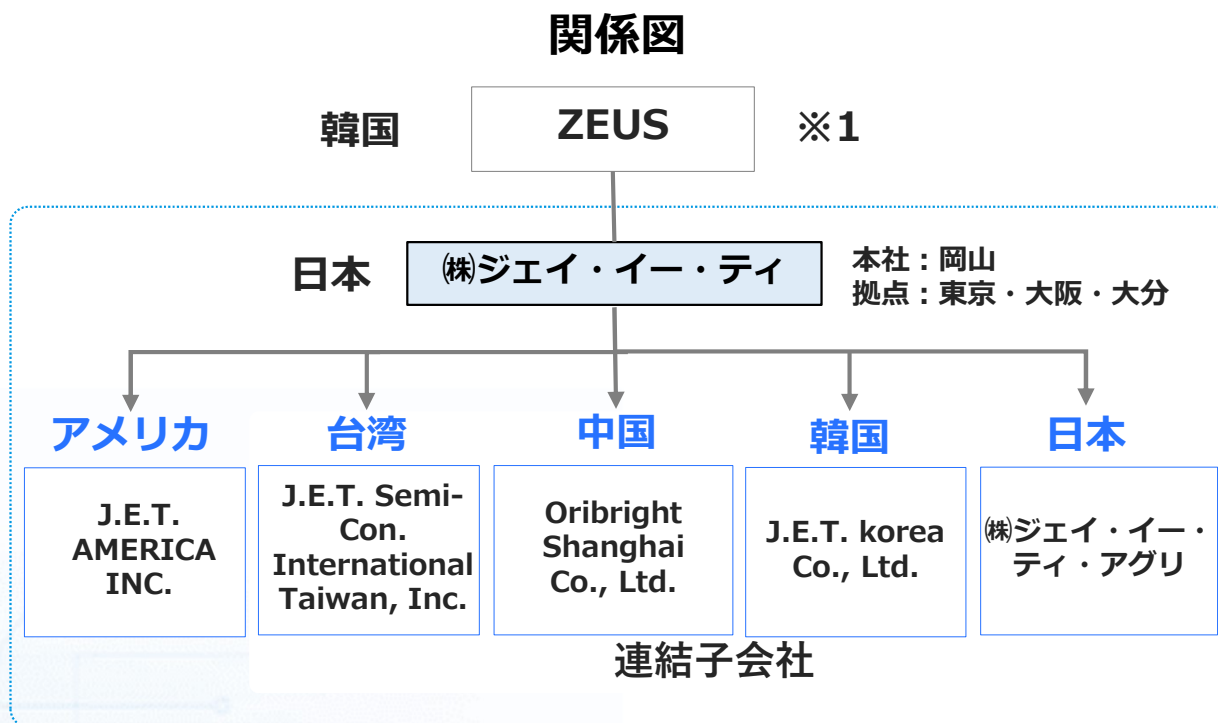
資本金： 15,530,995千KRW

事業の内容： 半導体・液晶用各種製造装置の製造・販売

当社の議決権の
保有割合(%)： 66.4% (直接)

関連当事者
との関係： 営業取引

取引の内容： 双方より部品・材料等の販売・仕入及び
装置製造業務委託、
当社よりZEUSへ販売手数料支払い等



※1 韓国取引所KOSDAQに上場

* 2022年4月末までは、当社にてZEUSより非常勤取締役1名を受け入れていたが、2022年5月以降、ZEUSから当社への役職員の出向等による受け入れは行っていない。

- 国内拠点
- 海外拠点



韓国拠点 29名

J.E.T. korea Co., Ltd.

- Oribright Shanghai Co., Ltd. 北京事務所
- Oribright Shanghai Co., Ltd. 無錫事務所
- Oribright Shanghai Co., Ltd. 合肥事務所
- Oribright Shanghai Co., Ltd. 西安事務所
- Oribright Shanghai Co., Ltd. 広州事務所
- Oribright Shanghai Co., Ltd. 上海本社



中国拠点 75名

* 中国拠点については、一部の事務所の掲載を省略しております。

J.E.T. Semi-Con. International Taiwan, Inc.
(HEAD Office) 台湾本社



台湾拠点 27名

J.E.T. Semi-Con. International Taiwan, Inc.
(Singapore branch) シンガポール支社

シンガポール 3名

九州出張所(※1)

大阪事務所(※2)

東京事務所(※1)

(株)ジェイ・イー・ティ

- 本社
- 笠岡ファーム(※3)

本社 (岡山)



- ※1 東京事務所及び九州出張所では、当社顧客へのフィールドサービスを提供。
- ※2 大阪事務所は、LIB製品の営業を担当。
- ※3 笠岡ファームでは、当社連結子会社(株)ジェイ・イー・ティ・アグリがトマトを栽培。



JET AMERICA INC.

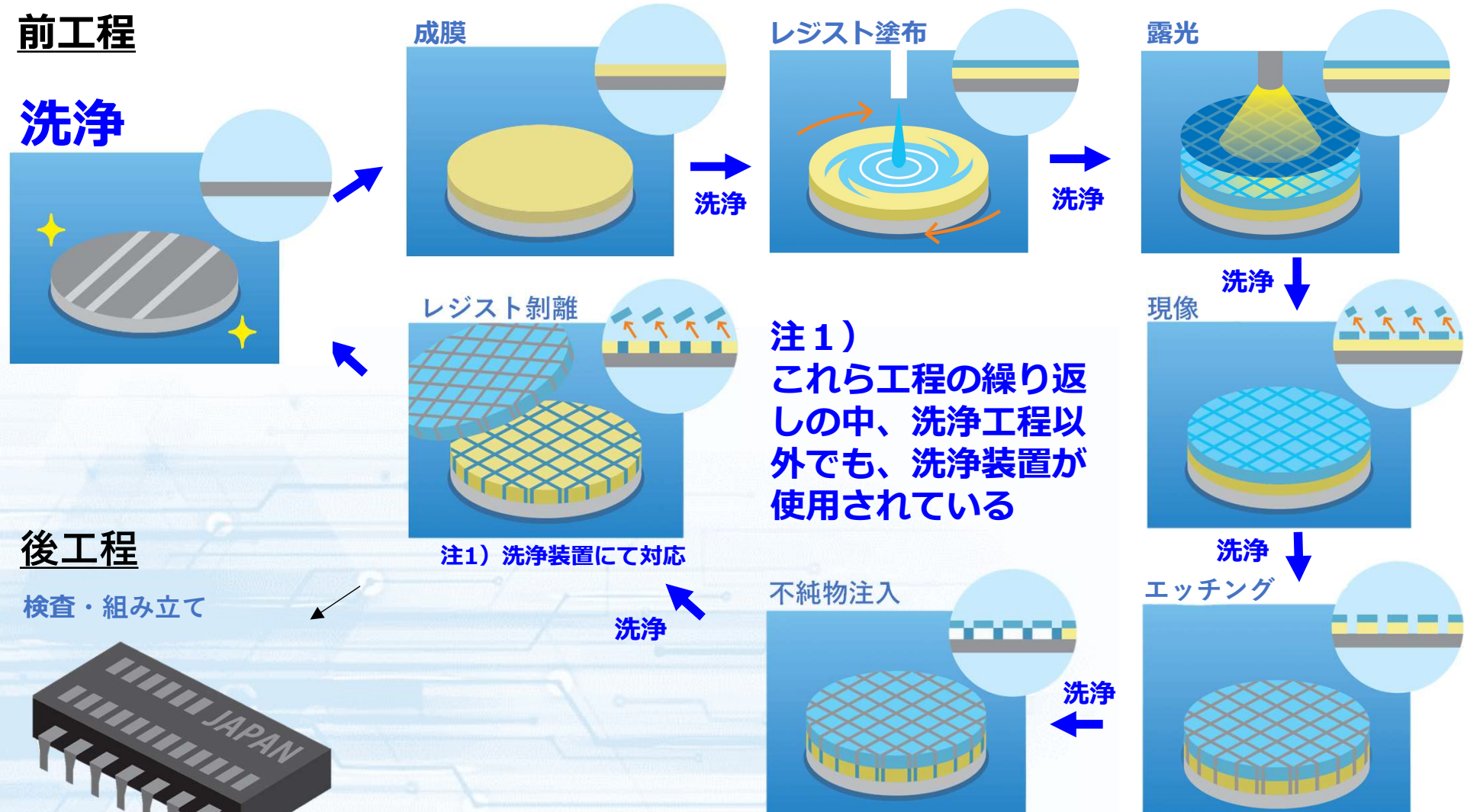
米国拠点 3名

半導体製造プロセス 前工程

半導体製造プロセス前工程（500工程以上）において、洗浄は極めて重要な工程
前工程の30~40%（工程数ベース）が洗浄装置を使用する工程と考えられている

前工程

洗浄



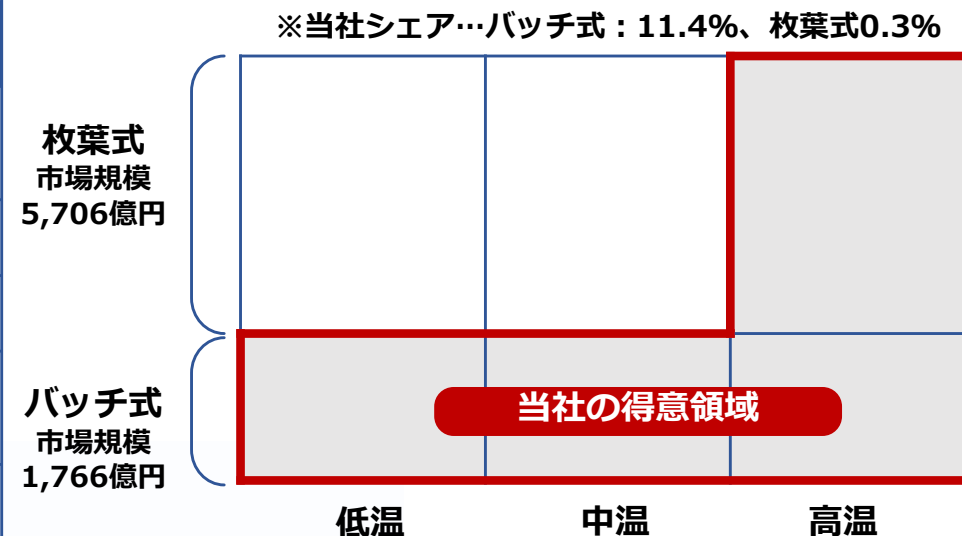
注1)
これら工程の繰り返しの中、
洗浄工程以外でも、
洗浄装置が
使用されている

注1) 洗浄装置にて対応

注1) 洗浄装置にて対応 ©J.E.T CO.,LTD. All rights reserved

半導体洗浄装置 バッチ式と枚葉式：当社の得意領域

		バッチ式洗浄装置	枚葉式洗浄装置
概要		25~50枚のウエハを一括洗浄	ウエハを1枚ずつ洗浄
長所		生産性が高い	精密な洗浄が可能
短所		ウエハの塵を拾い易い	生産性が低い
現状		生産性の優位性から一定のシェアを堅持	現在の主流洗浄装置
高温高粘度 処理	特徴	プロセス温度維持が容易	プロセス温度維持が難しい
	硫酸	○ (主流)	△ (一部対応)
	リン酸	○ (主流)	× (対応なし)
市場規模 (2022/世界)		1,766億円 (当社シェア 11.4%)	5,706億円 (当社シェア 0.3%)



競合状況と差別化要素

半導体洗浄装置は、2000年代以降日本企業が70%以上のシェアを持つと考えられており、特にA社、B社の存在感が大きい

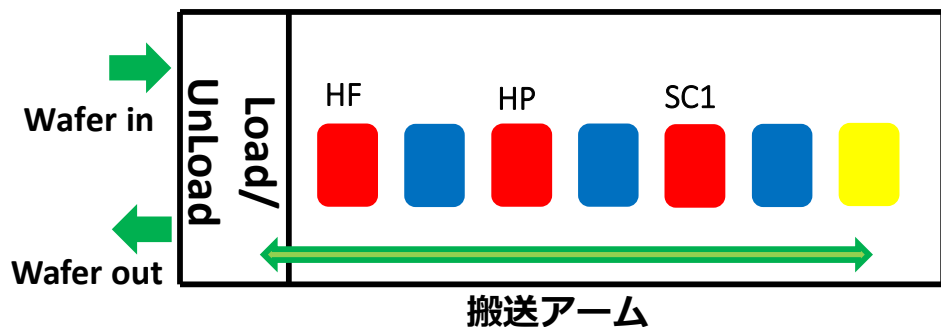
		当社	A社	B社
会社規模 (直近期売上高/営業利益)		244億円 (22億円)	4,608億円 (765億円)	2兆2,090億円 (6,177億円)
シェア (2022年度の 市場規模)	バッチ式 (1,766億円)	11.4% (202億円)	47.8% (835億円)	28.8% (508億円)
	枚葉式 (5,706億円)	0.3% (11億円)	48.5% (2,170億円)	28.3% (1,523億円)
技術	RCA洗浄	△	◎	○
	硫酸洗浄	◎	○	△
	リン酸洗浄	◎	○	△
	その他	○	△	○
生産能力		△ (量産能力は低い)	◎ (量産能力あり)	◎ (量産能力あり)
カスタマイズ性		◎ (カスタマイズ性に強み)	△ (標準化装置に強み)	△ (標準化装置に強み)

(出所) 経済産業省「令和5年6月 半導体・デジタル産業戦略」より、評価は当社独自の認識

- 当社の競合他社は、売上規模が数千億円～数兆円の大企業で、高品質で標準化した装置を量産できる点が強み
- 当社は量産能力に劣るものの、難易度の高い高温高粘度処理やカスタマイズ性の高さに強みがある
大企業が参入しづらいニッチ領域へ、小回りの利く当社が参入し、シェアを獲得している状況

JETバッチ装置の優位性 → 唯一F-Typeを持つ

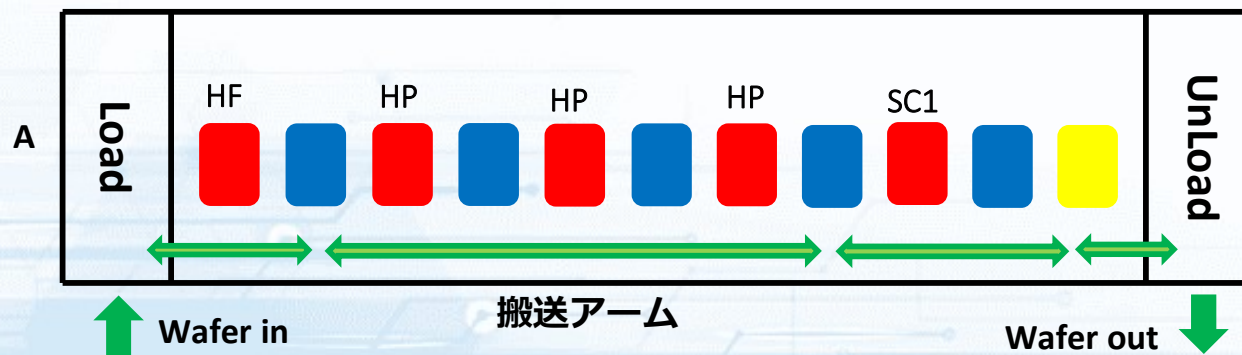
I-Type A社 / B社 / 当社



特徴

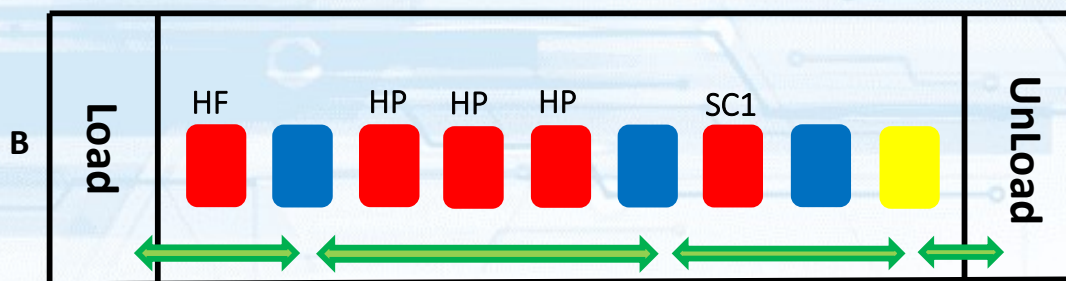
- コンパクト
- 処理槽 MAX 8 槽
(アームが左右に動き、渋滞が発生する為)
- スループット 最大250w/h

F-Type 当社のみ



特徴

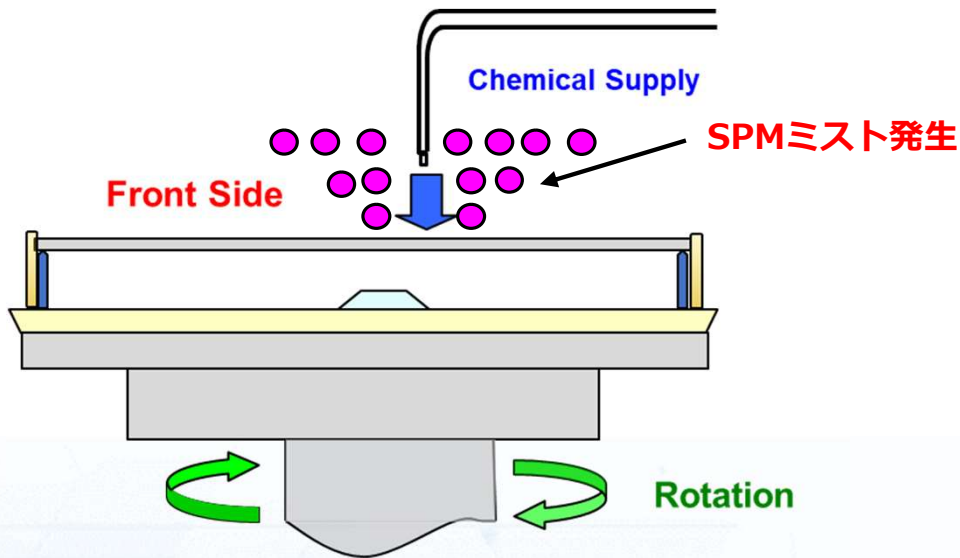
- 少し大きい
- 処理槽 MAX14槽
(アームが一方通行で、渋滞なしの為)
- A/B 選択可能
- Bはケミカル槽を連続配置可能
- 高温の硫酸・リン酸洗浄に多用
- **スループット 最大 500w/h**



* 2023年12月時点での当社独自の認識による。

当社 枚葉式装置の優位性

A/B社 枚葉式SPM装置



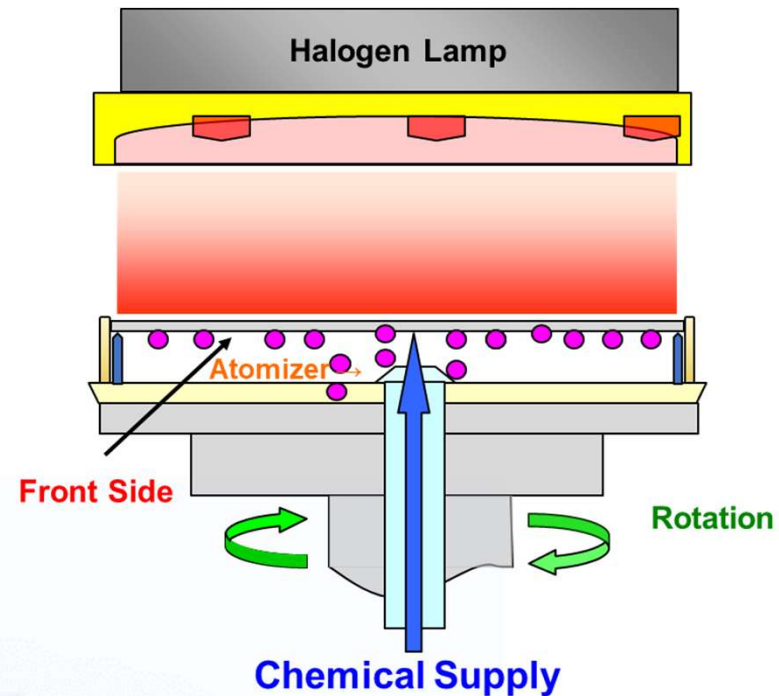
特徴

- 処理温度：150~200℃
- ケミカルの反応熱を利用
 - ➡ケミカルをかけ続けるも、高温維持は難しい
- プロセス時間：5min/HDIレジストウエハ (注)
- ➡必要ケミカル量：3000ml/ウエハ
(5分間ケミカルをかけ続ける必要がある為)
- SPMミストによりパーティクル発生量が多い

* HDIレジストウエハ=硬化層付きのレジストウエハ



* 2023年12月時点での当社独自の認識による。

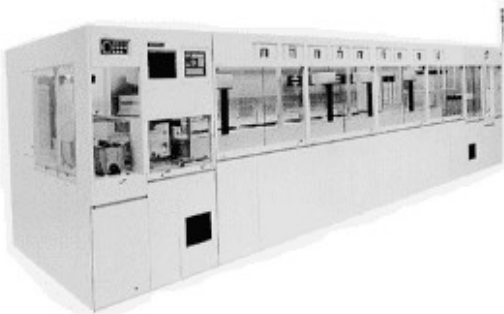

当社 枚葉式SPM装置 (HTS-300)



特徴

- 処理温度：200~240℃
- ハロゲンランプにて高温維持可能
- 処理面を反転し、霧状にしたケミカルを使用
- **プロセス時間：0.5min/HDIレジストウエハ**
 - ➡**必要ケミカル量：150ml/ウエハ**
- SPMミストが拡散せず、パーティクルの発生量が少ない

	BW3000	BW3700
		
洗浄方式	バッチ式洗浄装置 300mmウエハ対応	バッチ式洗浄装置 300mmウエハ対応
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ◎顧客要求に応えるフレキシブルな構成（洗浄槽の配列、数量を任意に対応可能） ◎生産効率の向上 ◎500WPHに対応する高速LD/ULD ◎装置設置面積が小さく、工場内への設置数を増やすことが可能 ◎二酸化炭素の低減 ◎気体流量のコントロールを実現 ◎標準化仕様化を進め、立上タイム短縮 ◎SEMI standardに対応 ◎EES（EDA or TDI）に対応 	<ul style="list-style-type: none"> ◎装置設置面積が小さく、工場内への設置数を増やすことが可能 ◎排気システムの個別配管により各処理槽の処理能力を安定化 ◎ウエハ間ピッチ7mm処理の実現 ◎ウエハの接触部の縮小化の実現によるパーティクル（微細なゴミ）の発生を減少 ◎気泡発生の低減化を実現 ◎リバースフローシステムにより液置換効率を向上 ◎濃度の安定性を向上 ◎豊富な処理槽種類に対応 ◎1薬液プラス1DIW構成に対応
価格帯 (平均単価) (百万円)	210~400	320~560

	BW2000	HTS-300
		
洗浄方式	バッチ式洗浄装置 200mmウエハ対応	枚葉式洗浄装置 300mmウエハ対応
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 高い生産効率 ◎ 高い洗浄能力 ◎ 省フットプリント ◎ 顧客要求に応えるフレキシブルな構成（処理槽の構成、数量の変更に対応） 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 最小150ccの薬液消費量での処理を実現 ◎ 最高240℃での高温処理を実現 ◎ 最短30秒でのストリップ処理を実現 ◎ ウエハ反転処理によるヒューム（薬液の蒸気）拡散防止の実現
価格帯 (平均単価) (百万円)	150～210	330～540

注意事項

本資料の取扱上の注意

- 本資料は、2024年11月8日発表の決算短信に基づいて作成されています。
- また、本資料に記載されている業績予想、将来予測などは、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、その情報の正確性、完全性を保証したり、約束したりするものではありません。また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度などの変化により、大きく見通しの変動する可能性があります。
- 本資料に記載しております数字につきましては、単位未満切り捨てで処理しております。また、比率は四捨五入しております。

本資料に関するお問い合わせ先

株式会社ジェイ・イー・ティ
経営統括本部

TEL 0865-69-4281